

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 8 月 18 日 (18.08.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/075380 A1

- (51) 国際特許分類⁷: **C04B 38/02**, B29C 33/38
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/000902
- (22) 国際出願日: 2005 年 1 月 25 日 (25.01.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2004-031678 2004 年 2 月 9 日 (09.02.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): TOWA 株式会社 (TOWA CORPORATION) [JP/JP]; 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 Kyoto (JP). 財団法人ファインセラミックスセンター (JAPAN

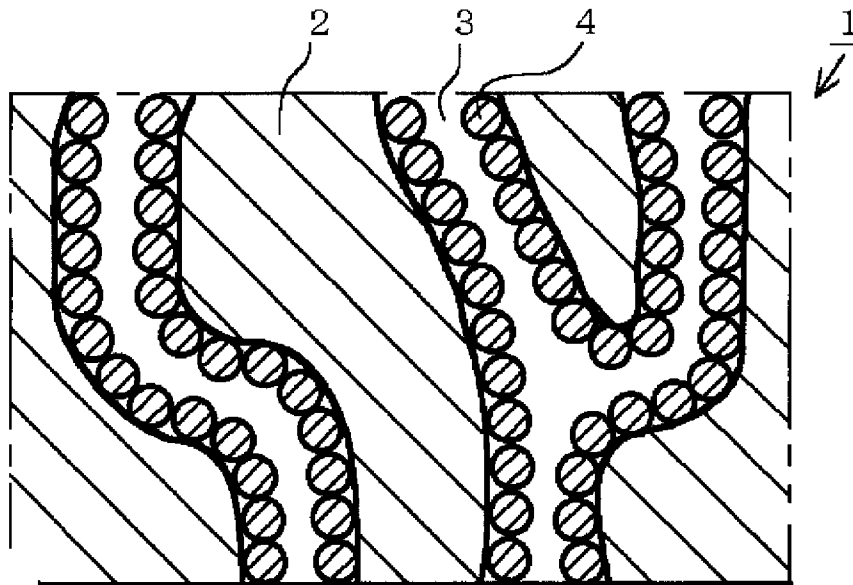
FINE CERAMICS CENTER) [JP/JP]; 〒4568587 愛知県名古屋市熱田区六野二丁目 4 番 1 号 Aichi (JP).

- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 久野 孝希 (KUNO, Takaki) [JP/JP]; 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 TOWA 株式会社内 Kyoto (JP). 前田 啓司 (MAEDA, Keiji) [JP/JP]; 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 TOWA 株式会社内 Kyoto (JP). 野口 欣紀 (NOGUCHI, Yoshinori) [JP/JP]; 〒6018105 京都府京都市南区上鳥羽上調子町 5 番地 TOWA 株式会社内 Kyoto (JP). 北岡 諭 (KITAOKA, Satoshi) [JP/JP]; 〒4568587 愛知県名古屋市熱田区六野二丁目 4 番 1 号 財団法人ファインセラミックスセンター内 Aichi (JP). 川島 直樹 (KAWASHIMA, Naoki) [JP/JP]; 〒4568587 愛知県名古屋市熱田区六野二丁目

[続葉有]

(54) Title: CONDUCTIVE POROUS MATERIAL, RESIN MOLDING USING IT, AND PROCESS FOR PRODUCING CONDUCTIVE POROUS MATERIAL

(54) 発明の名称: 導電性多孔質材料、それが用いられた樹脂成型型、および導電性多孔質材料の製造方法



(57) Abstract: A conductive porous material (1) comprising a substrate (2) having a sintered body of an oxide, communication holes (3) of very small diameter formed in the substrate (2) and exhibiting permeability to gas and impermeability to other substances, and conductive layers (4) formed on the inner walls of the communication holes (3) and generating heat as a current flows there through. Organic matters deposit to the inner walls of the communication holes (3) while the conductive material (1) is being used but the organic matters are decomposed and removed by heating the conductive layers (4). Consequently, clogging of the communication holes is prevented.

(57) 要約: 導電性多孔質材料 (1) は、酸化物の焼結体を有する基材 (2) と、基材 (2) に形成され、微小な径を有し、気体に対する透過性と気体以外の物質に対する不透過性とを有する連通孔 (3)

[続葉有]

WO 2005/075380 A1



4 番 1 号 財団法人ファインセラミックスセンター
内 Aichi (JP).

(74) 代理人: 深見 久郎, 外(FUKAMI, Hisao et al.); 〒
5300054 大阪府大阪市北区南森町 2 丁目 1 番 2 9 号
三井住友銀行南森町ビル 深見特許事務所 Osaka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護
が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA,
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,
BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,
BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

と、連通孔 (3) の内壁に形成され、電流が流れると発熱する導電層 (4) とを備えている。導電性材料 (1) が
使用されるにしたがって、連通孔 (3) の内壁に有機物が付着するが、導電層 (4) を発熱させることによって、
連通孔 (3) の内壁に付着した有機物が分解され除去される。それにより、連通孔の目詰まりが防止される。